

伍、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

1.所營業務之主要內容:

- (1) CC01080 電子零組件製造業。
- (2) CC01101 電信管制射頻器材製造業。
- (3) CC01110 電腦及其週邊設備製造業。
- (4) CC01120 資料儲存媒體製造及複製業。
- (5) CC01990 其他電機及電子機械器材製造業。
- (6) F119010 電子材料批發業。
- (7) F219010 電子材料零售業。
- (8) H201010 一般投資業。
- (9) I301010 資訊軟體服務業。
- (10) I501010 產品設計業。
- (11) JE01010 租賃業。

2.營業比重：

本公司成立於民國 86 年 5 月，以積體電路 IC 封裝測試業務為主，108 年度合併營業比重如下：

單位：新台幣仟元		
項 目	108 年度營收淨額	營業比重
封裝服務	40,183,544	60.41%
測試服務	17,623,648	26.49%
晶圓級封裝服務	3,446,149	5.18%
晶圓測試服務	4,851,085	7.29%
其他	420,718	0.63%
合 計	66,525,144	100.00%

3.目前之商品(服務)項目：

- (1)高腳數超薄小型晶粒承載積體電路(TSOP)封裝及測試服務。
- (2)四邊扁平無腳封裝(QFN)封裝服務。
- (3)多晶片(堆疊)封裝(MCP、S-MCP)封裝及測試服務。
- (4)球形陣列承載積體電路(wBGA、FBGA)封裝及測試服務。
- (5)記憶卡(SD、microSD)、USB 封裝及測試服務。
- (6)固態硬碟(SSD)、內嵌式記憶體(eMMC、eMCP、UFS) 封裝及測試服務。
- (7)DRAM 晶片堆疊封裝及測試服務。
- (8)行動記憶體封裝及測試服務。
- (9)晶圓測試服務。
- (10)晶圓凸塊(Bumping)封裝服務。
- (11)CPB 晶圓測試服務。
- (12)系統級(SiP)封裝服務。

- (13)重佈線(RDL)服務。
- (14)晶圓級晶片尺寸封裝(WLCSP)服務。
- (15)封裝體疊層(PoP、PiP)封裝及測試服務。
- (16)微機電系統(MEMS)封裝服務。
- (17)CIS 封裝及測試服務。
- (18)FC CSP 封裝型態。
- (19)環氧樹脂基板作為封裝載板的封裝服務。
- (20)樹脂成型穿孔導通技術開發(TMV)，以提供封裝產品堆疊需求服務。
- (21)銅柱凸塊覆晶(Cu Pillar Bump Flip Chip)封裝服務。
- (22)影像感測器(CIS)封裝服務。
- (23)EMI shield package 封裝服務。
- (24)晶圓級扇外型(Wafer level Fan-Out)封裝及測試服務。
- (25)面板級扇外型 (Panel level Fan-Out) 封裝及測試服務。
- (26)LPDDR3 KGD 測試服務。

4.計劃開發之新商品(服務)：

- (1)內埋連接晶片之 PiFO®封裝，以 Chip Middle 技術、Cu pillar 連結封裝兩側的 RDL 線路，以達成主動晶片間高密度晶片互連，預計於 2020 年底完成封裝層級可靠度驗證。
- (2)開發超細線寬線距(Fine RDL Line/Space 2/2um)之重佈線製程 (RDL)技術，可提供高效能、高 I/O、高頻寬互聯與高度異質晶片封裝的應用需求。
- (3)開發介電材料疊孔技術(Dielectric Stack Via)，搭配超細線寬線距之重佈線路達成高密度互連之應用。
- (4)開發乾膜介電材料(Dry Film Dielectrics)，達成更好的介電材料表面平整度 (Surface Coplanarity)之 FO 產品。
- (5)開發 Fan-out on FCBGA Substrate 技術，以細線路技術取代 2.5D Si interposer，達到兼具高效能及底成本的解決方案。
- (6)開發電鍍 Cu/Ni/SnAg 微凸塊技術，搭配 Fan-out on Substrate，提供可比擬 2.5D Si interposer 電性能而較低成本之封裝解決方案。
- (7)運用微細孔徑矽穿孔技術(TSV technology)，持續與重量級 CIS 客戶共同開發下一代高速且高解度析度的車用影像晶片。
- (8)運用矽穿孔技術(TSV technology)，持續與客戶開發堆疊層數更高的超大頻寬的高速記憶體。
- (9)開發車用 grade0 的 wire bond FBGA 封裝產品，以提供車用更高規格之相關應用的產品。
- (10)開發特殊結構的 CIS(CMOS Image Sensor)矽穿孔(TSV)晶片後段封裝製程，符合車用規範之相關應用的產品。
- (11)開發符合車用規範 grade0 的 FCBGA 封裝產品，以提供客戶車用高規格產品的需求。
- (12)開發大尺寸 110X110mm² FO 產品，以提供客戶高端封裝產品的需求。
- (13) Low k 低介電材料晶圓應用於繪圖用記憶體 GDDR6，以增進處理速度。
- (14)使用 LLHBM PKG 進行 FCBGA 結構封裝，以因應未來大型 FCBGA 封裝結構趨勢之所需之基礎技術建立。

- (15)開發使用 5nm 晶圓之 FCCSP Hybrid (覆晶+鐳線)的封裝產品結構，以提供客戶未來封裝產品的需求。
- (16)開發 ADAS FCCSP 車用雷達產品，以提供客戶車用高規格產品的需求。
- (17)運用薄型化玻璃來開發更輕薄的 CIS 影像晶片(CMOS Image Sensor)。
- (18)研究 CIS(CMOS Image Sensor)影像晶片相關矽穿孔(TSV)封裝材料薄化工程，以期符合高階產品輕薄的需求。
- (19)將積極突破晶片級封裝尺寸 7x7mm² 限制，開發出更大尺寸的 CIS (CMOS Image Sensor)影像晶片之晶片級封裝，此研究將有利於開拓高解析度的高階影像晶片市場。
- (20)多層重分布連線搭配晶圓凸塊製程開發，可增加晶片設計的彈性，讓同一種晶片實現多元化的封裝用途。
- (21)針對 FCCSP 開發 fine bump pitch,narrow gap between chips to SBT 來提升 FC 之製程封裝能力，以因應對於晶片微小化、薄型化之趨勢。
- (22)開發 FCBGA 55x55mm² & 77.5x77.5mm² 來提升 FC 之製程封裝能力，以因應未來 high speed interconnection requirement such as AI , server and networking 。
- (23)開發先進 CIS(advanced CMOS IMage Sensor)及超薄型矽晶圓封裝技術，以提供車用監視感測之產品應用。
- (24)開發高深寬比及細間距 TSV 之製程技術，以應用於未來先進之 CIS 封裝及 5G 產品需求。
- (25) PCIe Gen4 測試服務與硬體開發。
- (26) Higher Speed NAND 測試服務與硬體開發。
- (27) CIS 測試服務與相關硬體開發。
- (28) Drone 相關晶片測試服務與相關硬體開發。
- (29) Multi-Die Package 共用 COK 開發。
- (30) T5503A IOOCK LPDDR4 測試服務與硬體開發。
- (31) 5G 測試服務開發與硬體開發。

(二)產業概況

1.產業之現況與發展

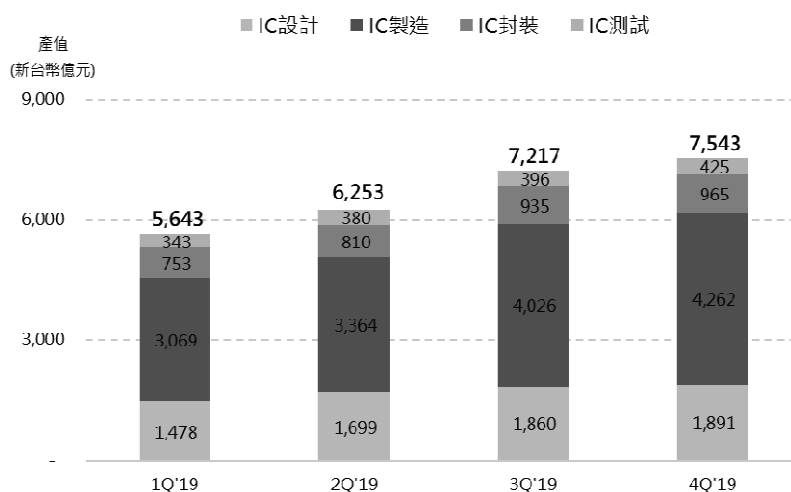
國際貨幣基金(IMF) 於 2020 年 1 月所發布的「世界經濟展望報告」中指出，2019 年全球經濟成長率為 2.9%，是自 10 年前全球金融危機以來經濟擴張最弱的一年，受到美中貿易戰、英國脫歐及主要經濟體景氣走緩的影響，使得 2019 年的全球經濟活動、貿易和投資明顯轉弱。

在經濟景氣不振的 2019 年，半導體產業亦受影響，根據美國半導體產業協會(SIA)和世界半導體貿易統計組織(WSTS)在 2020 年 2 月發佈的資料，2019 年全球半導體銷售總額為 4,121 億美元，與 2018 年的銷售總額 4,688 億美元相較，下跌了 12.1%；2019 年全球半導體總銷售量約為 9,320 億顆晶片，較 2018 年衰退 7.2%。若以區域別而言，以美國半導體市場銷售總額衰退幅度最大，達到 23.8%，其次為日本市場，衰退幅度為 10.0%，中國市場之衰退幅度則為 8.7%。

以 IC 類別而言，記憶體市場規模龐大，在半導體市場中占有舉足輕重的地位，過去 10 年間，DRAM 約佔全球半導體市場產值的 14~16%，NAND Flash 則佔有 11~12%，2019 年記憶體市場受到市場需求下滑，OEM 庫存水位過高的影響，全球 DRAM 平均售價(ASP)下滑 47.4%，全球記憶體市場產值下滑 31.5%，記憶體市場下滑是半導體市場衰退的重要因素。

受到美中貿易戰影響，中國企業加大自主研發晶片的投資力道，並尋求台灣半導體產業鏈協助，因此 2019 年台灣半導體產業呈現逐季成長走勢；依工業技術研究院產科國際所之統計，2019 年台灣 IC 產業產值達新台幣 26,656 億元，較 2018 年成長 1.7%，其中 IC 封裝業為新台幣 3,463 億元，較 2018 年成長 0.5%，IC 測試業則為新台幣 1,544 億元，較 2018 年成長 4.0%。

2019年台灣IC產業季度產值圖



資料來源: 工業技術研究院產科國際所，力成科技整理，2020。

2019年台灣IC產業產值統計值

單位：新台幣億元

	1Q'19	年成長	2Q'19	年成長	3Q'19	年成長	4Q'19	年成長	2019全年	年成長
IC設計	1,478	7.7%	1,699	4.7%	1,860	4.7%	1,891	15.1%	6,928	8.0%
IC製造	3,069	-14.1%	3,364	-4.7%	4,026	5.5%	4,262	8.3%	14,721	-0.9%
IC封裝	753	-0.3%	810	-6.9%	935	0.5%	965	8.4%	3,463	0.5%
IC測試	343	3.3%	380	10.8%	396	0.8%	425	6.3%	1,544	4.0%
IC產業	5,643	-6.4%	6,253	-2.0%	7,217	4.4%	7,543	9.8%	26,656	1.7%

資料來源: 工業技術研究院產科國際所，力成科技整理，2020。

2.產業上、中、下游之關聯性

我國 IC 產業依製造流程區分，可依次分為上游的 IC 設計(IC Design)、中游的 IC 晶圓製造(IC Manufacturing and Foundry) 及下游的 IC 封裝及測試 (IC Assembly & Testing)。

(1)上游：

IC 設計公司為積體電路產品設計公司，屬於知識密集產業，該行業進入障礙高投資報酬率亦高，吸引國內不少廠商投入，其主要業務為自行設計產品銷售，或接受客戶委託設計。

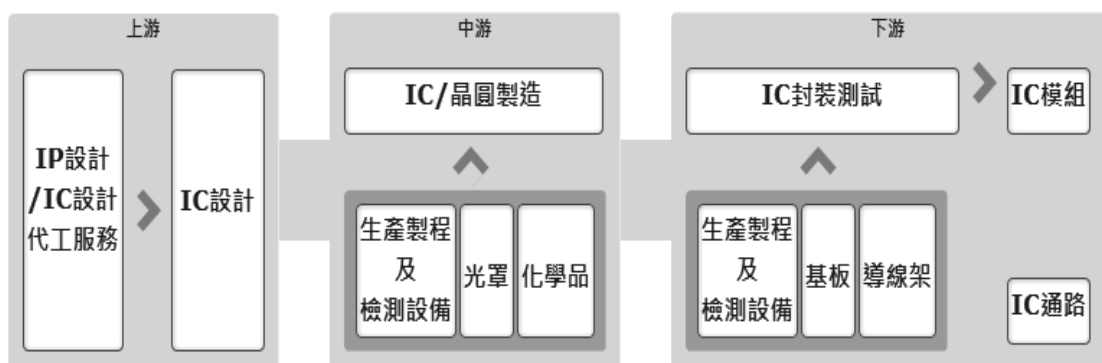
(2)中游：

為 IC 製造業與化學品工業，其主要業務是將自行設計的 IC 電路或客戶委託加工的 IC 設計，以精密的設備從事 IC 晶圓生產，屬資本密集且技術密集的行业，進入障礙高。

(3)下游：

封裝測試業是將製造完成之 IC 晶圓進一步切割後予以封裝及測試，以便能應用在最終產品。

所屬半導體產業上、中、下游之關聯性，如下圖所示：



近年來市場對 IC 的質和量要求越來越高，IC 除了要功能強大和面積小外，同時也要求多功能整合，使得 IC 製造和封測的界線越來越模糊，除了晶圓代工廠的產品服務開始延伸 IC 封測領域，大多數的晶圓廠則是與合作緊密的封測廠共同開發，或封測廠與系統廠共同設計開發解決方案。

3.總體經濟與產業發展趨勢及產品競爭情形

(1)總體經濟與產業發展趨勢

IC 封裝測試是 IC 製造的後段作業，包括封裝與測試二項作業程序，主要提供 IC 保護、散熱、電路導通等功能。封裝技術的演進可分為使用導線架的導線封裝與使用載板的無導線封裝。最初是導線封裝階段，以打線接合的方式，將晶片連接至外引腳上，而接腳的位置則位在晶片四周；然後則是載板封裝，使用上以載板取代導線架，對外電路的連通則改用錫球，而錫球(對外的接腳)則為位在晶片的下方；另外有不再使用導線架或錫球，而是直接將晶片置放於母板上，藉由金屬凸塊與載板接合的覆晶封裝技術；隨著電子終端產品

持續朝輕薄短小及高速整合運算、省電等趨勢發展，讓扇外型封裝持續受到市場關注，特別是在扇外型封裝之同/異質晶片或與被動元件整合製程技術開發方面，更是被視為明日之星般的技術。

現今封裝技術二大發展區塊，一是單晶片系統設計 SoC(System on Chip)，是將系統電路整個設計在晶片中，包括中央運算處理單元(CPU)、暫存記憶體(Flash memory 或 SRAM)、數位訊號處理器(DSP)、輸出入介面電路(I/O interface)...等。另一為系統封裝 SiP(System in Package)，它可將不同數位或類比功能的裸晶，以凸塊(bump)或打線(wire bond)方式連結於晶片載板上，該載板中已有部分內埋被動元件或電路設計，此具有電性功能的載板，稱為整合性基板 (Integrated Substrate)或功能性基板 (Functional Substrate)，系統封裝方式也視應用需求而有所差異，例如一般平面型的 MCM(Multi-chip Module)封裝法，或是節省面積將不同功能晶片堆疊起來的 3D 堆疊封裝法，這些都屬於系統封裝(SiP)技術的發展範疇。

雖說環顧系統單晶片(SoC)與系統封裝(SiP)，是目前半導體封裝發展二大方向，不過系統單晶片發展至今卻面臨技術瓶頸，如生產不良率過高、研發時間過長、成本太昂貴...等問題，因此後者強調小面積、支援高頻、高速、低成本、生產週期短...等優點的多晶片模組封裝技術，便成為目前極受重視的解決方案。由於半導體先進製程微縮技術及晶片成本逐漸遇到瓶頸，宣告摩爾定律已逐漸走到瓶頸，加以物聯網終端產品強調異質整合(如 Sensor、Logic/DRAM 與 GPU、IoT 產品等)，使得以封裝方式達到異質整合(特別是與感測器的整合是 SoC 難達到的)解決方案成為熱門議題，而此解決方案就是系統級封裝(System in package)；晶圓廠台積電以其製程布局晶圓級 SiP 封測技術(如 CoWoS、InFO 技術)，在基於輕薄省電部份已帶領手機 AP 的硬體規格上，走向扇外型封裝發展，因扇外型封裝用在手機 AP 可較原本覆晶封裝薄 20%以上，符合手機朝薄型化的發展趨勢，另外在散熱、省電、及效能方面亦較覆晶封裝有優勢，價格上較 3DIC 便宜，亦符合消費者對電子產品在價格上的需求，而這些都意味著扇外型封裝技術將成為智慧型手機 AP 發展主流。除了台積電之外，大多數的晶圓廠則是與合作緊密的封測廠共同開發，或封測廠與系統廠共同設計開發，這便造就了封測廠與晶圓廠或系統廠更緊密結合。

本公司為因應產業及技術發展態勢及上游客戶對記憶體、邏輯及先進封裝測試產能日益增加的需求，適時購置新設備以提高產能，以持續提供且盡力滿足現有客戶封裝及測試服務，並以此為基礎更積極朝向低成本高效能封裝技術前進，於 2018 年 9 月投資興建全球第一座使用面板級扇外型封裝(Fan-Out Panel-Level Packaging, FOPLP)製程的量產基地，力成科技看好面板級扇外型封裝技術未來的發展，可運用於 5G、AI、生技、自駕車、智慧城市及物聯網等的相關產品上，並對其未來產品的推廣有明顯的助益。本著未來封測產業會走向更多元化及高技術的趨勢，有能力研發出自家技術及培養穩定客戶訂單來源的廠商，將會是未來最大的贏家。

(2)競爭情形：

2019 年上半年受到全球景氣衰退、國際貿易情勢動盪與終端產品需求疲弱等不利因素影響，全球半導體封測市場環境挑戰大，但受惠於 5G 需求、記憶體價格跌勢趨緩及手機銷量漸有回升等因素，帶動 2019 年下半年全球半導體封測產業止跌回穩。

2019 年台灣 IC 封測業產值約為 5,007 億新台幣，佔全球半導體封測市場超過五成，全球前十大封測廠中有 5 家為台灣廠商。

本公司在封測領域耕耘多年，在堆疊式晶片封裝技術領域領先全球前五大半導體封測廠，2019 年全年累計營收為 665.25 億新台幣，其中 Flash 營收佔比為 38%、DRAM 營收佔比為 25%、邏輯晶片營收佔比為 27%、系統級封裝(SiP)及模組之營收佔比為 10%。

以往的系統單晶片(SoC)是把許多相同製程節點(technology node)元件整合在同一個晶片上，當先進製程持續推進到 7 奈米、5 奈米，IC 製造成本會大幅度提高，然而並非每一家 IC 設計公司都能夠負擔先進製程的昂貴成本，本公司著眼於此，積極研發各種先進封裝技術，在「異質整合」先進封裝技術與產能的佈局上領先同業，投入面板級扇外型封裝(Fan-Out Panel-Level Packaging；FOPLP)技術，透過 FOPLP 可將不同製程節點的不同功能元件進行整合，是較具成本效益的封裝方式，效能可與用先進製程製造的 SoC 相仿，換言之，是透過「把多個製程節點的元件異質整合在同一個晶片封裝上」，以協助客戶達成技術領先與提升經濟效益。

近年在國產替代進口、國家政策、資金支持以及創新應用等因素影響下，中國積極發展半導體產業，隨著新建的晶圓廠逐漸進入量產階段及大基金的資金挹注下，中國半導體封測企業亦步入快速發展，根據 DIGITIMES Research 的資料，中國半導體封測業者在市場需求考量下，主要以覆晶封裝(Flip Chip)及系統級封裝(System in Package；SiP)為現階段封裝技術主軸。

2019年全球前十大封測廠之台灣廠商排名及2014年~2019年成長態勢

單位：新台幣百萬元

公司 名稱	2019年 營收	19/18 成長率	2018年 營收	18/17 成長率	2017年 營收	17/16 成長率	2016年 營收	16/15 成長率	2015年 營收	15/14 成長率	2014年 營收
日月光	413,182	4.0%	397,261	36.8%	290,441	5.7%	274,884	-3.0%	283,302	10.0%	256,591
力成	66,525	-2.2%	68,039	14.1%	59,632	23.4%	48,344	13.7%	42,524	6.2%	40,039
京元電	25,539	22.7%	20,816	5.7%	19,686	-2.0%	20,081	17.2%	17,129	5.2%	16,278
頤邦	20,419	9.0%	18,725	16.4%	18,428	6.8%	17,256	2.3%	16,863	-4.6%	17,683
南茂	20,337	10.0%	18,480	3.0%	17,941	-7.5%	19,392	-2.4%	19,869	-9.7%	22,005

資料來源：公開資訊觀測站/各公司財報，力成公司整理

註：日月光與矽品於 2018 年 4 月時，以股份轉換方式設立日月光投資控股(股)公司

(三)技術及研發概況

1.研發費用

本公司最近年度研發費用支出情形詳如下表：

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	108 年度
研發費用	1,905,221

2.開發成功之技術或產品：

(1) 封裝產品方面的成果：

A.提供多樣性面板級扇外型封裝技術：

a.CHIEFS®封裝解決方案，以Chip First技術進行，開發完成晶片六面保護型 (6-side protection) 封裝，已於2019年完成封裝層級 (Package Level) 可靠度驗證。

b.CLIP® 封裝解決方案，以Chip Last技術進行，整合MLCC被動元件，已完成封裝層級 (Package Level) 可靠度驗證，未來將有機會應用於車用產品，如先進駕駛輔助系統 (ADAS)、車載娛樂 (Infotainment) 等產品。

c.PiFO® 封裝解決方案，內埋控制器元件 (Controller) 於扇外型封裝以取代傳統基板，並整合快閃記憶體晶片堆疊於其上，可得到超薄大容量之記憶體封裝，適用於手機、穿戴裝置等應用。

d.PiFO® 封裝解決方案，內埋多顆晶片於扇外型封裝中以取代傳統基板，透過相較於傳統基板較佳的結構厚度尺寸控制以及相對小的結構脹縮，得以符合高密度晶片互連之需求，為高階應用提供了新型式的內埋晶片基板選擇。

e.BF2O® 封裝解決方案，以無凸塊 (Bump-free) 扇出及重佈線技術提供深具成本競爭力的面板級扇外型封裝產品應用，適合需求輕薄短小的終端產品，目前手機電源管理晶片封裝已順利導入量產。

B.成功矽穿孔技術(Through Silicon Via)為基礎的高速高頻寬的八顆高階記憶體封裝的信賴性測試，即將配合客戶銷售計劃於109年第三季正式邁入量產。

C.開發出特殊玻璃載具，使矽穿孔技術(TSV technology)整合製程更加簡化，晶片堆疊良率更為提升，並進一步實現低成本的三維積體電路封裝 (3DIC)。

D.成功開發出特殊結構的CIS(CMOS Image Sensor)矽穿孔(TSV)晶片封裝，此結構為實現超薄且超大解析度影像晶片更進一步。

E.成功開發並導入量產車用grade2的wire bond FBGA封裝產品，以提供車用相關應用之產品。

F.開發符合車用規範grade1的FCBGA封裝產品，以提供客戶車用高規格產品的需求。

G.繪圖用記憶體GDDR6，使用高散熱環氧樹脂以增進運算效能，已認證完成。

H.開始量產以矽穿孔(TSV)為主的封裝結構的生物晶片(BioChip)，利用此生物晶片可迅速確認受檢者基因排序，對於各種疾病定能發揮早療功效。

I. 成功開發超細被動元件間距之SiP封裝，提供更輕薄短小及低成本之封裝方案。

- J.多尺寸晶圓凸塊製程開發，可與內嵌型特殊基板搭配，與其他晶片做電性連結，可優化產品電性,改善產品效能。
- K.成功開發5G mmWave AiP FCCSP，且完成封裝認證,以因應5G產品需求。
- L.開發vertical wire interconnection技術，應用於堆疊4顆晶片的記憶體之扇出形封裝。以取代傳統16顆晶片堆疊打線封裝，達成低成本及短交期的需求。
- M.開發先進BIO CSP矽穿孔技術，以達成高容量的生物快速基因定序檢測功能。

(2) 測試產品方面的成果：

- A. UFS3.0系統級測試服務與硬體開發。
- B. LiDAR and GPS測試服務與硬體開發。
- C. 5G AiP OTA Test Chamber硬體開發。
- D. Teradyne Magnum V 3D NAND測試服務與軟/硬體開發。
- E. Teradyne Magnum Ux高速測試板開發。
- F. Fine pitch (<0.3mm) COK開發。

(四)長、短期業務發展計劃

茲就本公司有關經營、生產、行銷、研發等策略領域之短期及長期發展計劃之內容說明如下：

1.短期發展計劃

(1)積極擴充產能並開發新製程及技術

為因應半導體景氣持續成長及客戶需求之增加，擬積極擴充產能。另外，配合產品發展趨勢，將加強開發新製程及技術之能力，如 WLP、FC、SiP/Modules、2.5D/3D IC 以及 Fan Out 等先進技術開發，以提昇公司競爭優勢。

(2)持續縮短製程週期，以提供客戶更迅捷之服務

本公司之生產利基為彈性之製程，機動性高，未來將持續縮短製程週期，以提供客戶更迅捷之服務。

(3)持續提供整合性服務(Turn-Key Service)

由於上游晶圓廠基於成本考量，逐漸將 IC 之封裝及測試業務外移至專業封裝及測試廠，本公司為國內少數能同時提供封裝及測試之專業廠，為提供客戶較多的選擇、較佳的服務，以增加公司競爭力，未來將持續提供整合性服務予客戶。

(4)擴展國內外市場，擴大市場佔有率

藉由本公司彈性製程之高機動性及可提供整合性服務之優勢，除與現有國內外客戶維持良好關係之外，將積極爭取國內外新客戶，擴大市場佔有率。

2.長期發展計劃

(1)注重客戶與供應商長期合作發展關係

強調與上下游廠商的長期合作，在產業專業分工的趨勢中，本公司將成為客戶信賴的封裝測試加工廠，提供客戶需要的品質與服務，同時也與供應商建立良好的合作關係。

(2)提高自動化設備之投資，加速生產線自動化，提高產品良率，增進生產效率，降低人力之依賴。

(3)持續開發新型封裝測試技術與新客戶

半導體技術日益精進，已從微米時代進入奈米時代，基於 IC 體積愈漸縮小且多樣化，使得高階 IC 封裝測試之技術需求日漸殷切，本公司 95 年初成立研發技術中心，全力投入封裝技術之研發，藉以滿足新舊客戶之需求及持續強化公司之競爭力。

(4)增加邏輯、模組(SSD)、微機電產品營收

藉由增加邏輯、模組(SSD)、微機電產品之客戶及營收，以擴大公司規模及分散風險。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1.主要商品(服務)之銷售(提供)地區

本公司主要產品為提供 IC 封裝及測試服務，銷售地區包含國內外市場，108 年度內銷比重約 20.15%；外銷比重為 79.85%，以日本、新加坡及美洲地區為主。

單位：新台幣仟元

銷售地 \ 年度	107 年度	%	108 年度	%
內銷	13,752,607	20.21	13,401,920	20.15
外銷	54,286,772	79.79	53,123,224	79.85
日本	22,270,182		23,245,391	
新加坡	14,947,281		13,147,802	
美洲	13,167,078		12,634,897	
歐洲	2,052,881		2,367,141	
中國大陸及香港	1,381,878		1,133,562	
其他	467,472		594,431	
合計	68,039,379	100	66,525,144	100

2.市場占有率

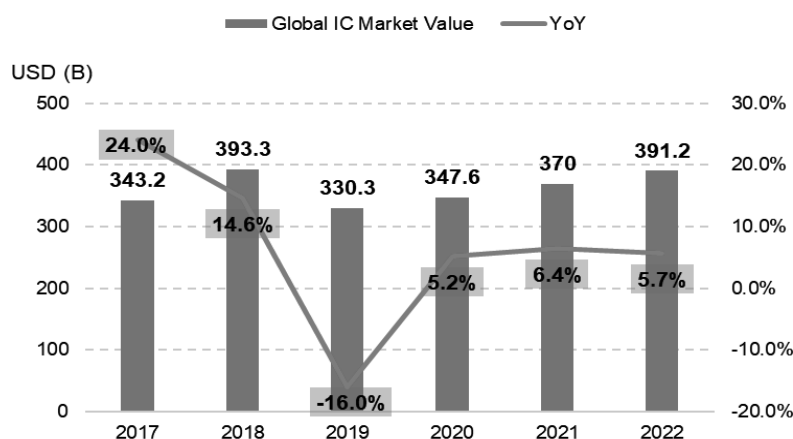
根據 TrendForce 及 DIGITIMES Research 研究資料顯示，本公司在 2019 年為排名全球第四大封測廠，若以台灣廠商而言，位居台灣封測廠商營收排名第二。根據工業技術研究院產科國際所於 2020 年 2 月所發佈之數據，2019 年台灣 IC 封裝產值約為新台幣 3,463 億元，測試業產值則為新台幣 1,544 億元，而本公司 2019 年封裝營業額約為新台幣 436 億元，占台灣封裝業產值 12.6%，測試業產值約為新台幣 225 億元，約占台灣測試業產值 14.6%，尤其本公司在記憶體 IC 之封裝測試方面居於領導地位。2018 年 9 月開始投資全球第一座使用面板級扇外型封裝(Fan-Out Panel-Level Packaging, FOPLP)製程的量產基地，看好面板級扇外型封裝技術未來的發展，可運用於 5G、AI、生技、自駕車、智慧城市及物聯網等的相關產品上。

3.市場未來之供需狀況與成長性

展望 2020 年，雖然美國與中國於 2020 年 1 月中正式簽署第一階段貿易協議，有助於降低全球經濟不確定性，然而新型冠狀病毒(COVID-19)疫情延燒，全球產業供應鏈受到衝擊，景氣擴張力道放緩。

世界半導體貿易統計組織(WSTS)預估，2020 年全球半導體市場將達 4,330 億美元，較 2019 年成長 5.9%。其中積體電路 (IC) 為 3,476 億美元，成長 5.2%、光電元件為 462 億美元，成長 12.5%、分離式元件為 249 億美元，成長 3.8%、感測器為 144 億美元，成長 5.4%。

2017 ~ 2022 年全球 IC 市場產值及年成長率

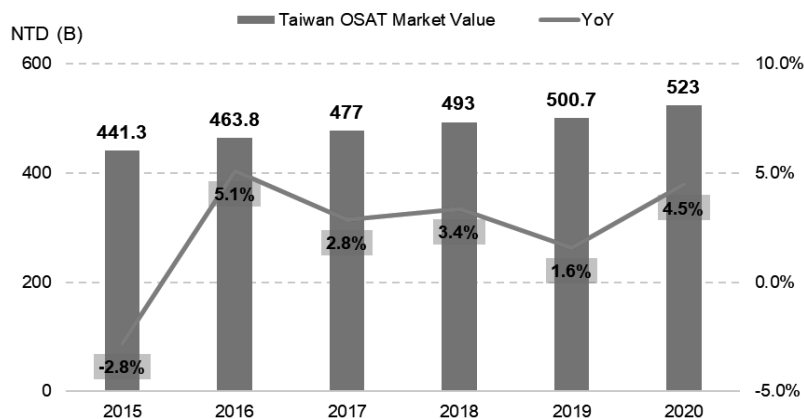


資料來源: WSTS及工業技術研究院產科國際所，力成科技整理，2020。

IC Insights 預估，2020 年智慧型手機、汽車電子系統以及人工智慧(AI)、雲端、巨量資料系統、深度學習應用等領域運算系統之半導體零組件將會是半導體產業的成長重心。

自 2019 年下半年開始的中國去美化運動依然方興未艾，加上中國 5G 基礎建設商機，台灣半導體封測業將可望以先進封測能量及晶片異質整合封測技術帶動產業成長，依據工業技術研究院產科國際所之統計，預期 2020 年台灣半導體封測產值將可達 5,230 億新台幣，較 2019 全年成長 4.5%。

2015 ~ 2020 年台灣半導體封測產值及年成長率



資料來源: WSTS及工業技術研究院產科國際所，力成科技整理，2020。

4.競爭利基

本公司自成立以來，以優良的品質，用心的服務，及創新的技術服務客戶，與客戶維持良好與密切之合作關係，已成為國內主要封裝測試廠。本公司具備之競爭利基如下：

(1)堅強的策略聯盟/走向全球化：

IC 封裝業及測試業與上游晶圓製造廠之互動程度高，因此，封裝及測試之獲利因素在於穩定之客戶來源，而 IC 製造廠鑑於其產品技術、產品品質、生產程序之保密性，亦會選擇與 IC 封裝及測試業之長期合作，因而形成策略聯盟，並與之有長期穩定之合作關係，有利於未來公司之長期發展。

(2)一元化服務(Turn-key Service)：

在 IC 價格快速下滑壓力下，本公司同時提供 IC 封裝及 IC 測試之一元化服務，以降低產品來回運送之成本與風險，以符合客戶需求，提高公司競爭利基。

(3)優秀的研發與製程能力：

本公司成立以來，即致力於新技術研發，且對技術研究及製程改良不遺餘力，至今已取得國內外多項專利，此外，並取得多家國際大廠的技術授權，這些皆是本公司優於同業之顯著能力，因此奠定力成之競爭利基。

(4)自動化及高精密度機台引進：

本公司因應積體電路 IC 產品朝高功能、高腳數及高積度發展，及為提昇為客戶服務品質，引進美日知名設備大廠自動化及高精密度設備，以符合客戶需求。

(5)網路自動化客戶服務系統：

本公司利用網際網路系統資訊傳遞及系統持續的改善，客戶可以隨時掌握產品問題及目前進度，瞭解產品狀況，有助於產品之改善及快速解決問題，提高對客戶之附加價值。

5.發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1)有利因素：

【產業環境】

①台灣半導體產業的競爭優勢

台灣半導體產業擁有完整的半導體產業結構，從上游的 IC 設計、晶圓製造至下游的封裝測試，垂直整合的產業鏈符合產業趨勢需求，造就台灣半導體產業在國際市場之競爭地位。IC 工業的榮景隨著全球電子、資訊、通信及光電工業、人工智慧以及物聯網的蓬勃發展，將使 IC 封裝、測試業持續穩定成長。

②IDM 大廠委外趨勢有利於封測市場

因先進製程需高額資本支出，使得全球 IDM 廠陸續擴大晶圓代工與封測委外業務於生產成本較低的亞洲地區，因此，具有 IC 產業完整與動態垂直分工體系的台灣，成為國際 IDM 與 IC 設計公司委外代工的首選，台灣封測廠亦獲益於 IDM 委外訂單。

【公司利基】

①穩健的策略聯盟及經營團隊—

本公司之股東組成包含國際知名之金士頓集團(Kingston Group)、台灣東芝先進半導體等，此有助於公司知名度之建立及訂單來源之穩定。隨著公司營業額穩定成長，及上述公司大力支持下，將來營運發展所需之資金亦不匱乏。另外，本公司之經營團隊皆具備半導體領域之完整資歷，並能洞悉市場趨勢，做出與時俱進的決策，使得公司能夠穩健成長。

②持續的研發及創新—

因應市場的快速變遷，本公司致力於技術深耕，除了研發新產品外，更透過技術合作引進新穎技術。研發團隊具備開發測試軟、硬體程式之設計能力及先進封裝技術；目前除了在 IC 測試方面持續開發測試程式、改良測試機台外，亦因應未來 IC 主流市場之需求，發展最先進的技術及服務，從記憶體的封裝測試，跨入邏輯市場，並由記憶體 IC 封測之優勢連結邏輯 IC，邁入 3D IC 之領域。封裝技術方面，已完成堆疊式 IC 技術的開發、具有調整路徑之導線架技術開發等並取得多項專利，並積極進行先進封裝技術研發，亦持續致力於材料、製程的改良。

③一元化的服務及彈性的產能—

本公司提供客戶 IC 產品封裝、測試、包裝等週邊服務，使客戶一次下單，可獲得整體性服務，並能縮短運送時間與節省運輸成本。此外，因應市場及客戶需求，迅速的進行產能擴充與調整，適時投資最先進設備，滿足客戶對產能的需求，提供客戶最具競爭力之解決方案。

(2)不利因素及因應措施：

①IC 產業隨景氣波動

因應對策：

A.產品多角化佈局

本公司除了持續強化在記憶體 IC 封裝測試技術及品質之外，入主超豐公司亦對本公司於邏輯業務之拓展有極大的助益，另外，銅柱凸塊(copper pillar bump)、金屬線路鋸墊重分配製程(Re-distribution；RDL)、晶圓級封裝(Wafer Level CSP)、微機電(MEMS)、固態硬碟(SSD)及面板級扇出型封裝等新製程技術已陸續通過驗證。公司藉由多角化的產品降低景氣循環的風險，提供客戶更多元化之封測服務。

B.強化與客戶的合作模式

與現有客戶建立長期夥伴關係，如成立力成半導體(西安)有限公司；並積極開發新客戶，使產能得到充分而穩定的利用。

C.擴大市場服務範圍

未來將以子公司力成科技秋田株式會社為日本的生產基地，同時配合另一子公司 Tera Probe Inc.，將在日本擁有完整供應鏈。

②原物料上漲，侵蝕毛利

因應對策：

A.降低生產之成本

改變產品結構、改善良率、提出可替代材料之解決方案，並持續改良製程能力，降低成本上漲之影響。

B.強調附加價值

持續站在客戶立場，提供品質好、交期短、快速應變客戶需求的服務，致力研發新的封裝測試技術，使客戶在市場上推出具有時效性及競爭優勢之產品。

③基層勞工短缺

因應對策：

A.提高員工福利並適時給予激勵獎金以吸引優秀人才加入，凝聚員工向心力。本公司依未來之發展計劃需要，擬定員工教育訓練，使員工與企業共同成長。

B.本公司引進先進之自動化機器設備，積極投入工業 4.0 開發，減低對基層員工之需求，有效提昇員工生產力。

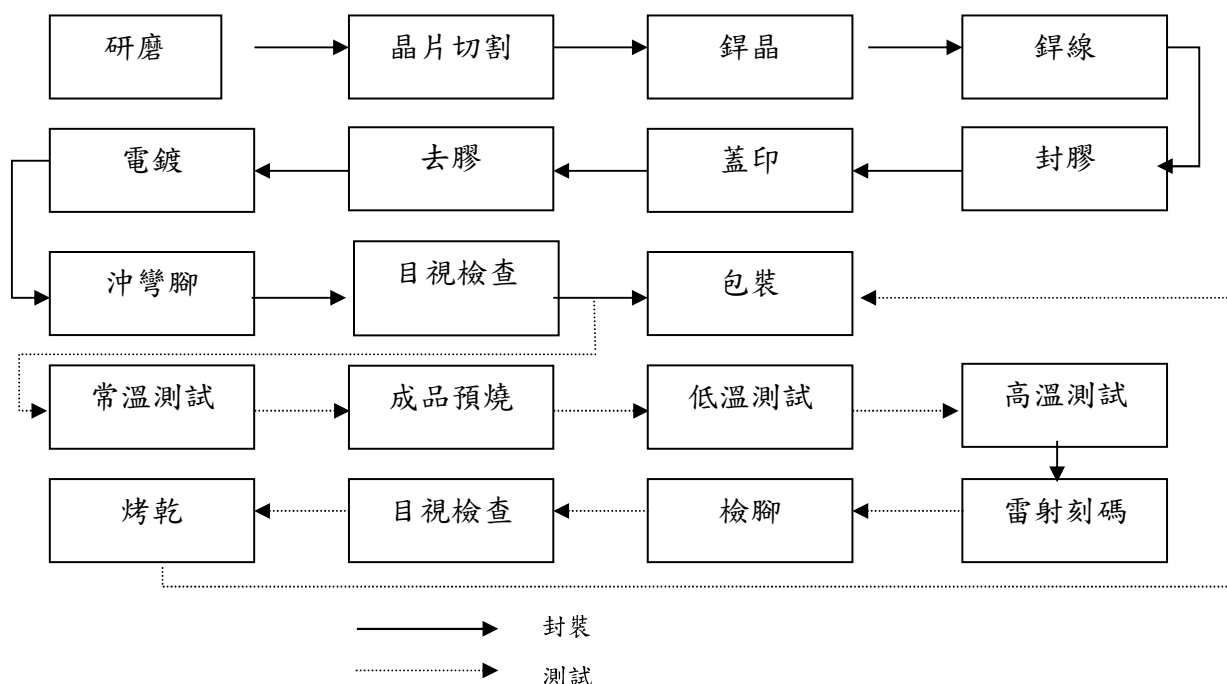
C.透過行政院勞工委員會之核准引進外勞，以解決勞工短缺之困擾。

(二)主要產品之重要用途及產製過程

1.產品用途：

主要產品或服務項目	重要用途或功能
積體電路(IC)封裝(Assembly)	將積體電路(IC)由晶圓產品經由切割、黏合、接線、封膠、切腳、成型等製程完成單顆成品。
環境分類測試 (Final Test)	依客戶所指定之測試條件，將產品 (IC) 置於不同的環境如常溫、高溫或低溫中測試並分類，確保客戶所提供的產品符合其所要求的品質及穩定性。
成品預燒 (Burn-In)	運用預燒 (Burn-In) 製程，讓產品 (IC) 處於極端的環境中運作，加速產品的老化並予以篩選，以確保產品的可靠性。
雷射刻碼 (Laser Mark)	於產品 (IC) 封裝上刻印廠商名稱及產品類別。

2.產製過程：



(三)主要原料之供應狀況

本公司主要是為客戶提供之 IC 予以加工，其中封裝作業需使用主要原料之供應狀況如下：

主 要 原 料	主 要 供 應 商
導線架(LEAD FRAME)	Shinko Electric、NICHIDEN SEIMITU KOGYO CO LTD.、復盛
基板(Substrate)	欣興、南亞、SIMMTECH、EASTERN、Shinko、景碩、Daisho、日月光半導體(上海)、Korea Circuit Co.,Ltd
黏晶膠(Die attach Film)	台灣日東、琳得科、Henkel、HITACHI CHEMICAL CO.(H.K.)LTD.
金線(GOLD WIRE)	日茂新、Tanaka
樹脂(COMPOUND)	台灣日立化成、Kyocera、晁揚、長華

(四)最近二年度任一年度中曾佔進 (銷) 貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進 (銷) 貨金額與比例，並說明其增減變動原因

1.本公司最近二年度並無佔進貨總額百分之十以上之供應商。

2.本公司主要銷貨客戶名單：

單位：新台幣仟元

項目	107 年				108 年				109 年度截至第一季止			
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係	名稱	金額	占當年度截至前一季止銷貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係
1	甲	14,923,812	21.93	關係人	甲	17,934,998	26.96	關係人	甲	5,187,943	27.58	關係人
2	乙	18,482,277	27.16	無	乙	14,818,184	22.27	無	乙	4,072,911	21.65	無
3	丙	8,673,567	12.75	無	丙	9,319,159	14.01	無	丙	2,959,458	15.73	無
	其他	25,959,723	38.16		其他	24,452,803	36.76		其他	6,591,368	35.04	
	銷貨淨額	68,039,379	100		銷貨淨額	66,525,144	100		銷貨淨額	18,811,680	100	

增減變動原因：因應產業及客戶需求的增加，本公司隨之擴增新產能，使得銷貨金額增加。

(五)最近二年度生產量值

數量單位：仟顆；仟片 金額單位：仟元

年度 生產量值	107 年度			108 年度		
	產能	產量	產值	產能	產量	產值
封裝	12,324,692	11,025,300	31,914,437	12,633,942	11,083,932	30,073,884
測試	9,129,235	6,960,538	11,480,104	8,861,588	6,715,326	13,151,756
晶圓級封裝	1,247	797	3,035,235	1,300	774	2,483,523
晶圓測試	3,282	2,571	5,094,738	1,204	1,068	2,272,550
合 計	21,458,456	17,989,206	51,524,514	21,498,034	17,801,100	47,981,713

(六)最近二年度銷售量值

數量單位：仟顆；仟片 金額單位：仟元

年度 銷售量值	107 年度				108 年度			
	內銷		外銷		內銷		外銷	
	量	值	量	值	量	值	量	值
封裝	6,055,816	8,390,151	4,988,870	33,407,896	6,304,864	8,519,264	4,815,833	31,664,280
測試	4,312,491	2,357,230	2,695,853	13,637,546	4,217,109	2,271,432	2,548,104	15,352,216
晶圓級封裝	165	915,240	635	2,807,917	176	881,556	551	2,564,593
晶圓測試	1,083	2,072,481	2,351	4,024,018	981	1,722,420	836	3,128,665
其他	—	17,505	—	409,395	—	7,248	—	413,470
合 計	10,369,555	13,752,607	7,687,709	54,286,772	10,523,130	13,401,920	7,365,324	53,123,224

三、從業員工資訊

最近二年度從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率一覽表

年 度		107 年度	108 年度	109 年度截至 3 月 31 日止
員 工 人 數	行政管理人員	1,369	1,435	1,450
	研發工程人員	2,381	2,394	2,466
	作 業 員	7,005	7,562	7,643
	合 計	10,755	11,391	11,559
平 均 年 歲		34.12	34.50	34.59
平 均 服 務 年 資		5.14	5.46	5.53
學 歷 分 布 比 率 %	博 士	0.11	0.08	0.08
	碩 士	7.74	7.77	7.87
	大 專	72.15	71.72	71.61
	高 中	19.49	19.96	20.03
	高 中 以 下	0.51	0.47	0.41

四、環保支出資訊

最近年度及截至年報刊印日止，公司因違反環境法規所受損失(包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容)，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：

(一)最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所受損失及相關處分內容：

新竹縣政府環境保護局於108年08月14日來文(環業字第1083402040號)，本公司3C廠有害事業廢棄物產生後貯存逾一年，已違反廢棄物清理法第36條第1項暨事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第7條規定，依廢棄物清理法第53條第2款裁處罰鍰新臺幣6萬元整。

矯正及預防措施：

於事件發生後，立即安排合格之廢棄物清理廠商清理有害事業廢棄物。預防措施：強化專責人員法規認知，並於廢棄物申報控管表新增暫存提醒功能，有效執行廢棄物管理作業。

(二)目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：

1.目前及未來可能發生之估計金額

擬購置之防治污染設備或支出內容如下：

項 目	單位：新台幣 仟元		
	109 年度	110 年度	111 年度
溫室氣體盤查輔導與查證費	360	360	360
繳交污水處理及排放費	25,000	30,785	30,785
廢水處理費用	37,624	40,000	40,000
環保監測檢驗費	800	966	966
事業廢棄物清除處理費用	55,000	55,000	55,000
擴充廢水處理設施	69,000	70,000	70,000
空氣污染測檢驗費	117	125	125
設置空氣污染處理設施	120,000	100,000	0
空氣污染防制費用	487	633	633
支出金額合計	308,388	297,869	197,869

2.環境維持措施

(1)環境管理計劃：

為善盡企業社會責任，本公司取得ISO14000環境管理系統認證，並透過污染防治設施系統妥善操作，維護永續環境，長期執行下列環境管理措施：

- A.廢氣處理：針對生產過程產生之揮發性有機化合物(VOCs)，本公司亦嚴格控管製程使用之化學品來預防空氣污染，並透過完善的防制設備(如活性碳、洗滌塔等處理設備)，有效抑制空污發生。
- B.製程用水回收：運用廢水回收設備，減少水資源消耗，將製程回收水量來取代自來水使用需求，以達節約用水及保護水資源之目的。
- C.廢水處理：本公司各廠區遵循環保署相關規定，廢水排放皆先經過污水處理系統才排放，且透過即時監控處理設備進行廢水管制，

水質皆處理至放流或納管標準才准許排放。

D.廢棄物清理：生產過程產生之廢棄物，皆依法妥善處理，並在產生廢棄物源頭確實做好分類收集以提高廢棄物之可回收性。

E.協力廠商稽核與輔導：定期稽核具環境污染風險之供應商與外包商，輔導協力廠商落實環境保護工作，共同履行企業環保責任。

F.節能減碳與溫室氣體：成立跨部門節能組織，執行節能專案，降低能源消耗與溫室氣體排放量；遵循 ISO14064-1 標準建立溫室氣體盤查管理流程，並委託專業機構進行輔導與查證，揭露碳排放資訊，以符合國際環保趨勢。

G.自主環境監測：規劃涵蓋廢水水質、噪音音量、空氣品質、廢棄物性質等各類環境自主監測計劃，有效掌控企業活動對環境品質造成之影響與衝擊。

H.環境許可變更：配合企業活動變化，適時提出各項環境許可之變更；使企業活動與污染排放均能符合環境法令之規範。

五、勞資關係

(一)公司各項員工福利措施、進修、訓練及其實施情形

力成科技重視人員的待遇與福利，依據各類獎金發放規範，提供合乎適用法律的員工福利，於每年度結算後之盈餘，扣除相關稅捐、公積及股息後，以固定比例撥予員工酬勞。

人才是支持公司不斷成長的最重要資產，也是企業永續經營的核心關鍵，我們秉持「共創、共榮、共享」的精神，致力於提供員工優質的工作條件，包含具有優渥、競爭力的薪酬福利及落實女男同工同酬、機會平等之目標，來吸引及留任各方優秀人才，以回饋同仁與公司共同創造佳績的辛勞與貢獻。期望能創造讓員工快樂工作、享受生活的優質環境，使員工安心工作，發揮工作潛能，一同成長。

1.保險方面：

除法定勞健保外，本公司員工均享有免費的團體綜合保險(包括壽險、意外險、醫療險、癌症險...等，員工不需負擔任何費用)。秉持照顧同仁及眷屬的角度，除了員工本人受惠外，亦加惠員工之配偶與子女，同樣享有免費團險。

2.健康與安全方面：

(1)廠區內備有保健室、哺乳室及醫師駐廠，透過專業醫療人員及健康管理，進行健康促進與管理員工的健康，公司也設有新進員工體檢補助及優於法規的定期員工免費健康檢查，以追蹤員工健康狀況。

(2)針對健康異常之高風險族群進行風險管控及復工評估，且不定期公佈健康資訊、進行職災防範宣導與安排健康講座。

(3)對於員工因異常工作負荷促發疾病之預防進行管理，預防發生對象為自覺有異常工作負荷主動通報之同仁，實施健康風險評估、過勞風險評估及佛明罕心血管疾病等評估，駐廠醫師依據綜合評估結果，進行諮詢及紀錄以維護同仁健康。

(4)力成科技於 2004 年通過 OHSAS 18001 職業安全衛生管理系統認證，為達預防職傷事故並維護安全 and 健康之工作場所目標，我們訂定「環境安全衛生政策」，以維護員工的安全和健康。



[環境安全衛生政策]

3.員工協助方面：

員工的健康是企業最大的財富！健康快樂的員工能為公司創造更高效益的績效。力成科技持續推動與提供多元的健康促進方案與關懷機制，並取得「健康職場認證 健康促進標章」，實踐對每位員工身心健康的重視，營造優質的健康工作環境。力成科技致力於提供優於法令的健康檢查、健檢異常追蹤與管理，以及擁有心理諮商與員工協助方案等措施。另也開辦健康舒壓課程，分別為熱力燃脂有氧舞蹈、瑜珈提斯課程，於 2019 年共辦理 5 梯次，共 10 堂課。請專業的師資提供同仁每周兩天的課程，於下班時間可直接至廠內的韻律教室進行運動，提供同仁一個舒適且完善的運動空間，讓力成員工在工作與生活間達到身心健康。

4.旅遊方面：

福委會不定期舉辦旅遊活動，充分連絡員工之間的情感，促進員工對組織的向心力，提升工作士氣。於 108 年度發放給每位同仁 2,000 元面額之娛樂券，並與知名旅行社簽約，讓同仁向旅行社購買旅遊行程或美食餐券，在辛勤工作之餘仍可以與家人朋友一起享受生活。

5.家庭日/大型活動/休閒活動方面：

福委會定期規劃家庭日及其他大型休閒活動，無論是力成員工或員工的家屬，都是力成的一家人，舉辦家庭日活動讓員工與家人一起同樂，讓員工與同事聯繫情感，讓員工與公益並行向前，為員工的工作之餘添上感動與幸福。我們致力於「打造友善職場」，創造讓員工快樂工作、享受生活的優質環境，所以打造專屬力成夥伴的一系列樂活動力，讓員工在工作與生活間達到平衡，讓員工在眾多活動中找到一個自己喜歡的活動，為員工打造力成精彩生活，在工作與生活中獲得持續性動力；同時，也為員工照顧其家庭，讓員工可以於工作時安心全力奮鬥。

福委會定期規劃家庭日及其他大型休閒活動，無論是力成員工或員工的家屬，都是力成的一家人，舉辦家庭日活動讓員工與家人一起同樂，讓員工與同事聯繫情感，讓員工與公益並行向前，為員工的工作之餘添上感動與幸福。我們致力於「打造友善職場」，創造讓員工快樂工作、享受生活的優質環境，「工作生活平衡」是我們致力於打造友善職場宗旨，除了提供豐富的薪酬福利，也辦理多元的活動項目，我們不只照顧力成人，也照顧力成人的家人，藉此 1.傳達力成文化、2.照顧力成夥伴、3.凝聚力成向心力，以激發夥伴專心創造更多無限的可能。

- (1)傳達力成文化：在各項活動中傳達「共創、共享、共榮」的企業文化，鼓勵夥伴間盡可能創造與分享，透過夥伴間的知識共享，是讓力成持續成長的來源之一。
- (2)照顧力成夥伴：讓夥伴在工作與生活間達到平衡，讓員工在眾多活動中找到一個自己喜歡的活動，為員工打造力成精彩生活，在工作與生活中獲得持續性動力；同時，也為夥伴照顧其家庭，讓夥伴可以於工作時安心全力奮鬥。
- (3)凝聚力成向心力：透過活動增加夥伴與公司、夥伴間的連結機會，凝聚團隊向心力，以拓展個人人際網絡，當夥伴建立起人際網絡，將助於人才留任且在組織裡可獲得更多資源，而提升工作效率且有更好的工作表現。

6.社團方面：

目前共有 9 個同仁自主創立的社團，社團性質包含運動類(壘球社、羽球社、保齡球社、籃球社、慢跑社)、藝文類(手工藝品社、禪學社)、志工類(志工社)等，共計 648 位社員。每年各社團除了有例行性的社團活動，也會舉辦全公司性的活動，提供社員與非社員、同仁與非同仁交流機會，包含壘球社定期代表公司參加壘球比賽、慢跑社舉辦的力成跑跑人活動吸引新竹地區跑者一同共襄盛舉，不僅增加同仁紓壓管道，同時也增進同仁間的情誼與建立企業形象。

7.休假方面：

本公司比照勞基法規定給予每月例假及年度休假，並定期提供統計報表供主管瞭解關懷同仁休假狀況，以協助同仁達成工作與生活之均衡。

8.生日婚喪及其他福利項目：

- (1)每月發予壽星 500 元祝賀禮券，並針對同仁婚喪喜慶及住院、重大災害等，提供 1,000 至 10,000 元不等的補助金。
- (2)每年勞動節提供 1,000 元等值的現金/禮券/禮品。
- (3)每年端午節及中秋節等節慶，提供各 1,000 元等值的禮券/禮品。
- (4)每年針對年資滿 3、5、10、20 年同仁，給予禮品或禮券一份。

9.生育補助及相關服務：

本公司致力打造幸福企業，關心員工及其家庭的互動，不僅提供許多關懷且照護同仁的生活與家庭，婚育照顧由老至幼、本人到眷屬擴及整個家庭，讓同仁在力成可以安心工作。

制度／項目	說 明
特約產檢醫院 月子中心	透過福委會簽訂員工居住區域之特約醫療院所及月子中心，讓同仁懷孕階段與坐月子期間以較優惠的價格得到好品質的服務。特約家數：8 家
生育補助	依據生產胎數計算，每胎補助 2,000 元。
哺乳室	鼓勵產後同仁哺集母乳，各廠區設置集乳室，內備有冰箱及安心舒適之個人專屬空間，以供哺乳的媽咪同仁使用。
員工團體保險	為全體員工(含正式、契約人員)及其配偶與子女(不限人數)投保團體保險，保障範圍包含重大疾病壽險、門診住院手術醫療險、防癌險等，讓員工及其家庭都能獲得更多保障。
托兒優惠措施	透過福委會簽訂員工居住區域之特約優良幼兒園、托兒機構，提供員工子女就讀的選擇及學前教育、課後安親的照料，讓同仁無後顧之憂兼顧職場與家庭。 托兒機構數：18 家。
員工子女 夏令營	為員工子女(大三以上之畢業生或在學生)設計的「展翅高飛－新鮮人夏令營」活動，給即將邁入職場的孩子們一劑強心針，讓他們藉此機會瞭解父母親服務工作狀況及產業屬性，拉近親子間的關係及提升家人的認同感。
力成科技教育 基金會獎助學金	為鼓勵為獎助有心向學之優秀學子，培育人才，針對同仁就讀高中職、大專院校在學之子女提供獎助學金補助。

10.食宿方面：

- (1)本公司設有餐廳，提供自助餐，用餐皆有公司補助，同仁僅須支付少許餐費即能享有豐盛之餐點。107 年成立「伙食管理委員會」，透過定期的會議召開討論公司膳食議題，更健全了餐廳及伙食的管控。
- (2)為使遠道員工就近解決住的問題，公司備有員工宿舍，提供舒適之生活環境。

11.進修及訓練：

我們以「傾聽」、「訪談」、「線上調查」等方式來考量公司內部需求與外部新議題，致力滿足「同仁學習的需求」、「產品品質的需求」、「組織成長的需求」，以及「公司策略的需求」，架構「解決需求導向」的課程辦理模式與訓練體系，更積極培養各階層接班人才，確保企業的永續經營。並針對同仁之需求，開辦新進人員訓練、專業技術訓練等各類教育訓練，提供員工完整的專業技能養成及自我成長啟發。

(二)退休制度與其實施情形

力成科技遵照「勞動基準法」及「勞工退休金條例」訂定員工退休辦法，並設立勞工退休準備金監督委員會，按月足額提撥退休準備金至法定帳戶，截至108年底舊制退休準備金帳戶金額約為2.5億元，可滿足勞工符合退休條件時請領退休金。108年度會計帳列合計提撥之新、舊制退休金費用總額為320,385仟元，以期同仁皆能於退休後享有安心的保障。

(三)勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

1.勞資溝通：

力成科技重視同仁聲音，提供各種溝通管道以促進勞資雙方之溝通協調，深入瞭解員工對管理與福利制度之滿意度，維持良好的勞資關係，並讓同仁可放心的在無報復的友善環境中表達自己的意見。除了預防勞資糾紛發生並將其降到最低，積極的透過溝通管道會議、勞資會議及全區福委會，針對特定議題反映同仁的建議及看法，與公司達成共識，創造勞資和諧幸福工作的環境。

2.全方位溝通管道：

我們建構全方位的溝通管道（如圖所示），多元、雙向、開放的反映機制，透過落實員工溝通、意見的傳達，使同仁的心聲得以有效被處理及回覆。同時為了讓溝通管道的運作能展現成效，我們制定了「溝通作業管理程序」、「性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法」、「員工心理諮商輔導辦法」、「獎懲管理辦法」及「社會責任溝通作業管理程序」，來落實溝通管道的管理。

我們隨時關心及傾聽同仁的各種聲音，不論具名或匿名反映，均以公正、保密、迅速的處理過程，解決同仁的疑惑，若同仁對於處理結果不服，亦設置「再反映管道」機制，可尋求第三方單位協助，更能客觀及更完善的解決同仁問題，來強化良好勞資關係的建構。



(四)最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失（包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容），並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：

處分日期	處分字號	違反法規條文	違反法規內容	處分內容
108/12/2	府勞資字第1093930028	勞動基準法第24條第1項	雇主延長勞工工作時間者，其延長工作時間之工資，依下列標準加給： 一、延長工作時間在二小時以內者，按平日每小時工資額加給三分之一以上。 二、再延長工作時間在二小時以內者，按平日每小時工資額加給三分之二以上。 三、依第三十二條第四項規定，延長工作時間者，按平日每小時工資額加倍發給。	(1)罰鍰新台幣7萬元 (2)公布處分人名稱及負責人姓名
		勞動基準法第32條第2項	雇主延長勞工之工作時間連同正常工作時間，一日不得超過十二小時；延長之工作時間，一個月不得超過四十六小時，但雇主經工會同意，如事業單位無工會者，經勞資會議同意後，延長之工作時間，一個月不得超過五十四小時，每三個月不得超過一百三十八小時。	

六、重要契約

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
封測加工承攬合約	A 公司	108.06~	封測服務 權利義務規範	保密條款
封測加工承攬合約	F 公司	108.12~109.12	封測服務 權利義務規範	保密條款
封測加工承攬合約	I 公司	108.12~111.12	封測服務 權利義務規範	保密條款
銀行 借 款 合 約	中國信託商業銀行	108.09~111.09	中期信用貸款	承諾維持一定比例之 資產與負債及淨值
	兆豐國際商業銀行	108.12~111.12	中期信用貸款	無
	元大銀行	108.01~112.01	中期信用貸款	承諾維持一定比例之 資產與負債及淨值
	凱基銀行	107.12~111.12	中期信用貸款	承諾維持一定比例之 資產與負債及淨值
	玉山銀行	106.09~121.09	建造廠辦大樓	無
		106.09~113.09	建造廠辦大樓	
		108.05~111.05	中期信用貸款	
	華南銀行	108.09~111.09	中期信用貸款	無
		108.03~111.03		
		108.07~111.07		
		108.06~111.06		
	第一銀行	108.08~111.08	中期信用貸款	無
		108.05~113.05		
		101.11~116.11		
		105.11~110.11		
	台灣銀行	106.09~111.09	機器設備貸款	無
		108.10~113.10	機器設備貸款	
		106.04~121.04	建造廠辦大樓	
		106.04~113.04	中期信用貸款	
	合作金庫	106.09~111.09	機器設備貸款	無
		108.10~111.10	中期信用貸款	
		108.08~111.08	中期信用貸款	
	彰化銀行	106.03~112.03	機器設備貸款	無
		106.06~112.06	機器設備貸款	
		108.05~114.05	機器設備貸款	
		108.01~111.01	中期信用貸款	
	台新銀行	108.01~111.01	中期信用貸款	承諾維持一定比例之 資產與負債及淨值
	王道銀行	108.07~111.07	中期信用貸款	承諾維持一定比例之 資產與負債及淨值
	土地銀行	108.10~111.10	中期信用貸款	無
	匯豐銀行	108.09~111.09	中期信用貸款	無
	國泰世華銀行	108.11~111.11	中期信用貸款	無
	上海銀行	108.01~111.01	中期信用貸款	無
	日商三菱日聯銀行	108.10~111.10	中期信用貸款	無